

 '05年3月期 中間決算説明会補足説明資料
The First Half Year ended September 30,2004
Analyst Guide

株式会社 フェローテック (証券コード:店頭 6890)
Ferrotec Corporation Code-No.6890 (JASDAQ)

2004年11月30日
Nov. 30, 2004

目次 Contents

	ページ	Page
1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method		1
2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)		2
3. 連結貸借対照表(負債・資本の部) Consolidated Balance Sheet (Liabilities,Minority interests and Shareholders'equity)		3
4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income		4
5. 期初計画と実績との差異 Review in the first half		5
6. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)		6
7. 期初計画と修正計画との差異(下期) Outline of the revised plan (The second half)		7
8. 期初計画と修正計画との差異(通期) Outline of the revised plan (The accounting period)		8
9. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows		9
10. 連結セグメント別売上高 Segment Information (Consolidated)		10
11. 主要製品の売上推移 Change in sales of main products (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております/Entry amount cuts less than one million yen and be displaying)		11

本資料は、当社グループの評価を行うための情報提供を目的としたものです。
本資料に記載された数値等は資料作成時点のものであり、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
本資料に基づいた投資等の結果に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

This report is provided solely for the information of professional analysts who are expected to make their own evaluation of the consolidated Subsidiaries.
We don't guarantee the accuracy or completeness of information herein.
Unless otherwise stated, estimates or forecasts are solely those of our company as of the above-mentioned date and subject to change without notice.
We accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report.
This report isn't intended for the use of private investors.

1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method

連結子会社11社、持分法適用会社2社 Consolidated Subsidiaries (11), Company Accounted for by the Equity method(2)

子会社 Subsidiary	所在地 Country	主要製品 Major Products	資本金 Capital Stock	出資比率 Equity Ownership
杭州大和熱磁電子有限公司 HANGZOU DAHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	コンピュータシール、サーモモジュール、CMS Computer Seals, Thermo-electric Modules, CMS	2,545百万円 2,545million yen	99.9%
上海申和熱磁電子有限公司 SHANGHAI SHENHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	磁性流体、サーモモジュール、CMS Ferro Fluid, Thermo-electric Modules, CMS	2,577百万円 2,577million yen	100.0%
杭州日磁科技工業園有限公司 HANGZHOU NIPPON-MAGNETICS SCIENCE INDUSTRY PARK DEVELOPMENT CO.,LTD.	中国 China	その他 Others	650百万円 650million yen	100.0%
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD.	シンガポール Singapore	コンピュータシール、石英 Computer Seals, Quartz	1,300千シンガポールドル 1,300 thousand Singapore dollar	100.0%
Ferrotec (USA) Corporation	米国 USA	真空シール、サーモモジュール Vacuum Feedthroughs, Thermo-electric Modules	24,966千ドル \$ 24 thousand	100.0%
Ferrotec Investments,LLC	米国 USA	その他 Others	350千ドル \$350 thousand	100.0%
Ferrotec GmbH	ドイツ Germany	その他 Others	511千ユーロ 511thousand euro	100.0%
(株)フェローテック精密 Ferrotec Precision Corporation	日本 Japan	真空シール、その他 Vacuum Feedthroughs, Others	225百万円 225million yen	100.0%
(株)フェローテックオーツ Ferrotec Quartz Corporation	日本 Japan	石英 Quartz	475百万円 475million yen	100.0%
(株)フェローテックシリコン Ferrotec Silicon Corporation	日本 Japan	シリコンインゴット、シリコンウェハ Silicon products, CMS	181百万円 181million yen	100.0%
アリオンテック(株) ALIONTEK CORPORATION	日本 Japan	石英 Quartz	93百万円 93million yen	44.0%
持分法適用会社 Company Accounted for by the Equity Method				
ダイヤセルテック(株) DIACELLTEC CORP.	日本 Japan	リチウムイオン2次電池 Litium-Ion Rechargeable Battery	480百万円 480million yen	49.0%
杭州菱日科技有限公司 (ダイヤセルテックの100%子会社) HANGZOU LINGRI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	中国 China	リチウムイオン2次電池 Litium-Ion Rechargeable Battery	350百万円 350million yen	

* アリオンテック(株)は商法上の子会社ではないが、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める連結子会社。

2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)

(単位 百万円、%)

科目	Title of account	04/3		04/9		前期末比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	増減率 YOY	
流動資産	Current assets	11,976	41.4	12,735	42.5	759	6.3	
現金及び預金	Cash and Deposits	3,123	10.8	2,973	9.9	150	4.8	
受取手形・売掛金	Notes and accounts receivable	4,298	14.9	5,261	17.5	963	22.4	
たな卸資産	Inventories	2,791	9.6	3,037	10.1	246	8.8	1. 主なたな卸資産
その他	Other assets	1,903	6.6	1,624	5.4	279	14.7	真空シール 433百万円 石英 863百万円
貸倒引当金	Allowance for doubtful receivables	140	0.5	162	0.5	22	15.7	シリコンウエハー 384百万円
固定資産	Fixed assets	16,958	58.6	17,257	57.5	299	1.8	
有形固定資産	Tangible fixed assets	10,622	36.7	11,156	37.1	534	5.0	2. 主に上海子会社CMS関連の投資により増加
建物・構築物	Building and Structures	3,234	11.2	3,425	11.4	191	5.9	
機械装置・運搬具	Machinery and Equipment	3,445	11.9	3,630	12.1	185	5.4	
工具器具備品	Tools, furniture and fixtures	963	3.3	1,033	3.4	70	7.3	
土地	Land	2,602	9.0	2,601	8.7	1	0.0	
建設仮勘定	Construction in progress	375	1.3	465	1.6	90	24.0	
無形固定資産	Intangible fixed assets	2,644	9.1	2,450	8.2	194	7.3	
営業権	Goodwill	1,715	5.9	1,747	5.8	32	1.9	
その他	Other assets	928	3.1	703	2.3	225	24.2	3. 主に連結調整勘定の財務健全化のための一時償却
投資その他の資産	Investments and other assets	3,692	12.8	3,650	12.2	42	1.1	(188百万円)により減少
投資有価証券	Investment securities	1,643	5.7	1,315	4.4	328	20.0	4. 投信の売却(100百万円)及び投資有価証券の時価
その他	Other assets	2,071	7.2	2,364	7.9	293	14.1	下落等により減少
貸倒引当金	Allowance for doubtful assets	22	0.1	30	0.1	8	36.4	
資産合計	Total assets	28,934	100.0	29,992	100.0	1,058	3.7	

参考. 換算レート表

	03/3期		03/9期		04/3期		04/9期	
	02/12	03/3	03/6	03/9	03/12	04/3	04/6	04/9
US\$	119.90	120.20	119.80	111.25	107.13	105.69	108.43	111.05
Singapore \$	69.16	68.01	68.12	64.37	62.94	62.91	63.21	65.69
RMB	14.49	14.51	14.43	13.45	12.94	12.75	13.09	13.41

各期の左側は、子会社の換算レート(子会社は12月決算の為)です。

3. 連結貸借対照表(負債・資本の部)

Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	04/3		04/9		前期末比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	前期比 YOY	
流動負債	Current liabilities	9,253	32.0	10,738	35.8	1,485	16.0	1. 有利子負債の内容 短期借入金 + 1年内長期借入金 6,130(5,599)百万円 長期借入金 + 転換社債 6,224(6,923)百万円 合計 12,354(12,522)百万円 *カッコ内は04/3期末 単体合計 7,162百万円(前期末比 95百万円減)
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payables	1,889	6.5	2,377	7.9	488	25.8	
短期借入金	Short-term borrowings	3,197	11.0	3,768	12.6	571	17.9	
1年内返済予定長借入	Current portion of long-term borr.	2,401	8.3	2,361	7.9	40	1.7	
賞与引当金	Accrued corporation taxes	107	0.4	136	0.5	29	27.1	
その他	Other current liabilities	1,658	5.7	2,094	7.0	436	26.3	
固定負債	Long-term liabilities	7,101	24.5	6,394	21.3	707	10.0	
転換社債	Convertible bonds	1,870	6.5	1,776	5.9	94	5.0	
長期借入金	Long-term borrowings	5,053	17.5	4,448	14.8	605	12.0	
その他	Other long-term liabilities	178	0.6	170	0.6	8	4.4	
負債合計	Total Liabilities	16,355	56.5	17,133	57.1	778	4.8	
少数株主持分	Minority interests	24	0.1	45	0.2	21	87.5	
資本金	Common stock	5,824	20.1	5,871	19.5	47	0.8	
資本剰余金	Capital surplus	6,700	23.2	6,747	22.5	47	0.7	
利益剰余金	Profit surplus	293	1.0	615	2.1	322	109.9	
その他有価証券評価差額金	Securities valuation adjust.	210	0.7	117	0.4	93	44.3	
為替換算調整勘定	Cumulative translation adjust.	313	1.1	377	1.3	64	-	
自己株式	Treasury stock-at cost	160	0.6	160	0.5	0	-	
資本合計	Total shareholders' equity	12,555	43.4	12,813	42.7	258	2.1	
負債、少数株主持分及び資本合計	Total liabilities, Minority interests and Shareholders' equity	28,934	100.0	29,992	100.0	1,058	3.7	

* 事業セグメントと製品区分 Business Segments and Product Lines

装置関連	Equipment related	電子デバイス	Electronic device	受託生産	CMS
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	コンピュータシール	Computer Seals	受託生産	Contract Manufacturing Service
石英製品	Quartz	サーモモジュール	Thermo-electric Modules		
シリコン製品	Silicon related products	磁性流体・その他	Ferrofluid & Others		
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others				

4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	03/9		04/9		前期比 YOY	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	6,824	100.0	10,783	100.0	58.0	<p>1. 事業セグメント別の状況</p> <p>(1) 装置関連: 半導体・FPD製造装置向けに真空シール・部品伸長、石英製品も新規顧客の開拓が進みほぼ倍増。</p> <p>(2) 電子デバイス: 半導体・バイオ向けにサーモ40%増収、コンピュータシールも堅調に推移</p> <p>(3) CMS: シリコンウェハー加工が本格稼働、装置部品洗浄も顧客の認定取得が進展、中国市場向け工作機械製造も堅調に推移。</p> <p>2. 売上総利益の増加及び利益率改善のポイント</p> <p>(1) 増収効果</p> <p>(2) 製造の中国移管に伴うコストダウンの顕在化</p> <p>(3) CMS事業の稼働本格化</p> <p>3. 販管費増加要因(但し、対売上比は9.5ポイント低下)</p> <p>(1) 増収に伴う変動費の増加</p> <p>(2) 引き続き経費削減を継続するも、抑制していた一部経費の復元</p> <p>(3) 前年同期よりも為替レートが円安水準で推移したことも一因</p> <p>4. 営業外損益</p> <p>(1) 主に親会社の債権・債務の為替評価による差益の発生</p> <p>(2) 持分法投資損失は持分法適用関連会社の繰延税金資産取崩しにより増加</p> <p>5. 特別損益の主な内容</p> <p>特別利益: 投資有価証券売却益 26百万円、固定資産売却益 39百万円</p> <p>特別損失: 固定資産処分損 86百万円、連結調整勘定償却 188百万円</p>
売上原価	Cost of sales	4,678	68.5	7,366	68.3	57.5	
売上総利益	Gross profit	2,146	31.5	3,417	31.7	59.2	
販管費	SG&A expenses	2,129	31.3	2,353	21.8	10.5	
営業利益(A)	Operating Income	16	0.2	1,063	9.9	6162.5	
営業外収益	Other income	92	1.4	236	2.2	156.5	
受取利息・配当金	Interest & Dividend Income	22	0.3	26	0.2	18.2	
賃貸収入	Lease income	19	0.3	11	0.1	42.1	
為替差益	Foreign exchange gain	-	-	121	1.1	-	
その他	Other income	50	0.7	75	0.8	50.0	
営業外費用	Other expense	376	5.5	359	3.3	4.5	
支払利息	Interest expense	155	2.3	151	1.4	2.6	
出資金評価損	Loss on devaluation of investments	48	0.7	0	0.0	-	
たな卸資産評価損	Loss on devaluation of Inventories	-	-	46	0.4	-	
持分法投資損失	Equity in loss of investees	81	1.2	99	0.9	-	
為替差損	Foreign exchange loss	51	0.7	-	-	-	
その他	Other expense	40	0.6	61	0.6	52.5	
経常利益	Recurring income	267	3.9	940	8.7	-	
特別利益	Extraordinary gain	55	0.8	72	0.7	30.9	
特別損失	Extraordinary loss	331	4.9	282	2.6	14.8	
税引前利益	Income before taxes	543	8.0	729	6.8	-	
法人税等	Income tax (current)	42	0.6	243	2.3	-	
同 調整額	Income tax (deferred)	0	0.0	6	0.1	-	
少数株主利益	Minority interest	0	0.0	21	0.2	-	
当期利益	Net income	499	7.3	458	4.2	-	
設備投資	Capital expenditures	1,136		1,163			主に中国子会社CMS関連投資(上海 382百万円 杭州 423百万円)
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	620		650			
研究開発費	R&D expenses	94		46			
EBITDA(A+B)	Cash flows	636		1,713			
1株利益(円)	EPS(yen)	29.3		26.8			
1株EBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	37.4		100.1			
1株配当金(単独、円)	DPS(yen)	0.0		0.0			
期末従業員数(人)	Number of employees	2,577		3,467			

5. 期初計画と実績との差異 Review in the first half

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	04/9計画 (A) Original plan		04/9実績 (B) Achievement			コメント
		金額	前年同期比	金額	前年同期比	計画比	
		Mil.Yen	YOY	Mil.Yen	YOY	B/A	
売上高	Net Sales	9,500	39.2	10,783	58.0	13.5	1. 連結売上高 期初計画が保守的であったこともあり、3セグメントいずれも計画を超過。 2. 売上総利益: 上記要因に加え、CMSの順調な拡大 3. 販管費: 経費削減努力による 4. 営業外損益: 為替に関しては安定して推移
売上原価	Cost of sales	6,324	35.2	7,366	57.5	16.5	
売上総利益	Gross profit	3,176	48.0	3,417	59.2	7.6	
販管費	SG&A expenses	2,446	14.9	2,353	10.5	3.8	
営業利益 (A)	Operating Income	730	4462.5	1,063	6162.5	45.6	
営業外損益	Other income & expense	190	-	123	-	-	
経常利益	Recurring income	540	-	940	-	74.0	
特別損益	Extraordinary gain & loss	220	-	210	-	-	
税前列益	Income before taxes	320	-	729	-	127.9	
法人税等	Income tax & others	120	-	272	-	-	
中間当期利益	Net income	200	-	458	-	128.9	

事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		04/9計画 (A) Original plan		04/9実績 (B) Achievement			コメント
製品	Product Lines	金額	前年同期比	金額	前年同期比	計画比	
		Mil.Yen	YOY	Mil.Yen	YOY	B/A	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	1,837	27.9	2,052	42.9	11.7	1. 装置関連 半導体・FPD関連投資の活況を受け、真空シールの引き合いが予想を超えて推移。中国への生産移管が完了した石英製品も認定取得が進み、新規顧客向けが伸びた。 2. 電子デバイス ユーザーのFDBモーター採用見送りで、減収が見込まれたコンピュータシールが増収。サーモジュールも自動車向け以外が計画超過。 3. CMS事業 ウエハー加工が順調、装置部品洗浄も認定取得が進み新規受注に成功。中国ローカルマーケット向けの工作機械製造も拡大。
石英製品	Quartz	1,731	42.4	2,094	72.2	21.0	
シリコン製品	Silicon products	532	36.8	497	27.8	6.6	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	660	10.4	696	5.6	5.5	
装置関連	Equipment related	4,760	26.0	5,339	41.3	12.2	
コンピュータシール	Computer Seals	561	14.0	697	6.9	24.2	
サーモジュール	Thermo-electric Modules	947	17.6	1,128	40.1	19.1	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	340	6.3	290	20.1	14.7	
電子デバイス	Electronic devices	1,848	1.6	2,115	16.3	14.4	
受託生産	CMS	2,892	135.7	3,328	171.2	15.1	
売上高合計	Total Sales	9,500	39.2	10,783	58.0	13.5	

6. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)

(単位: 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	04/3		05/3e		前期比 YOY	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	15,000	100.0	20,800	100.0	38.7	為替レート: 1ドル = 105円 1. 売上高: 半導体・FPD関連の減速を見込む 2. 売上総利益: CMSの構成比上昇等で総利益率低下 3. 販管費: 増収に伴い変動費は増加するものの、経費削減を継続 4. 営業外損益 (1) 支払利息310百万円程度を見込む (2) 前期は為替差損 318百万円発生
売上原価	Cost of sales	10,218	68.1	14,412	69.3	41.0	
売上総利益	Gross profit	4,781	31.9	6,388	30.7	33.6	
販管費	SG&A expenses	4,166	27.8	4,738	22.8	13.7	
営業利益(A)	Operating Income	615	4.1	1,650	7.9	168.3	
営業外損益	Other income	793	5.3	350	1.7	-	
経常利益	Recurring income	177	1.2	1,300	6.3	-	
特別利益	Extraordinary gain	103	0.7	72	0.3	30.1	
特別損失	Extraordinary loss	484	3.2	395	1.9	18.4	
税前利益	Income before taxes	559	3.7	977	4.7	-	
法人税等	Income tax & others	85	0.6	357	1.7	320.0	
当期利益	Net income	645	4.3	620	3.0	-	
設備投資	Capital expenditures	2,136		1,800			主に上海子会社CMS関連投資
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,177		1,300			
研究開発費	R&D expenses	188		100			
EBITDA(A+B)	Cash flows	1,792		2,950			
1株当たり利益(円)	EPS(yen)	37.89		36.22			
1株当たりEBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	105.34		172.35			
1株当たり配当(単体、円)	DPS(yen)	8.00		8.00			
期末従業員数(人)	Number of employees	2,800		3,500			

* 連単倍率 Consolidated/Non Consolidated ratio

		04/3			05/3e		
		単独(A)	連結(B)	連単倍率	単独(A)	連結(B)	連単倍率
		Non Consoli.	Consoli.	(A)/(B)	Non Consoli.	Consoli.	(A)/(B)
売上高	Net Sales	7,398	15,000	2.0	9,010	20,800	2.3
営業利益	Operating Income	105	615	5.9	310	1,650	5.3
経常利益	Recurring income	177	177	-	580	1,300	2.2
当期利益	Net income	18	567	-	225	620	2.8

7. 期初計画と修正計画との差異(下期) Outline of the revised plan (The second half)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	05/3下期 期初計画(A) Original plan		05/3下期 修正計画(B) Revised plan			コメント
		金額 Mil.Yen	前期比 yoy	金額 Mil.Yen	前期比 YOY	計画比 B/A	
売上高	Net Sales	10,500	28.4	10,017	22.5	4.6	1. 連結売上高: 足下堅調ながら、今後の事業環境を保守的に想定 2. 売上総利益: 売上構成の差異により利益率が計画比で良化 3. 販管費: 経費削減の継続と下期の円高を考慮し計画を修正 4. 営業外損益: 下期の円高等を考慮し修正
売上原価	Cost of sales	7,563	36.5	7,046	27.2	6.8	
売上総利益	Gross profit	2,937	11.5	2,971	12.8	1.2	
販管費	SG&A expenses	2,467	21.1	2,385	17.1	3.3	
営業利益(A)	Operating Income	470	21.5	587	2.0	24.9	
営業外損益	Other income	161	-	227	-	-	
経常利益	Recurring income	310	244.4	360	300.0	16.1	
特別損益	Extraordinary gain	60	-	113	-	-	
税前利益	Income before taxes	250	-	248	-	0.8	
法人税等	Income tax & others	100	-	87	-	-	
当期利益	Net income	150	-	162	-	8.0	

事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		05/3下期 期初計画(A) Original plan		05/3下期 修正計画(B) Modification plan			コメント
製品	Product type	金額 Mil.Yen	前期比 YOY	金額 Mil.Yen	前期比 YOY	計画比 B/A	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	1,855	11.1	1,848	10.7	0.4	1. 装置関連 足下堅調ながら、半導体・FPD関連投資の先行きを補修的に想定。セグメント売上高の下方修正は、主にシリコン製品、EB-ガン・その他の修正による。
石英製品	Quartz	1,759	22.0	1,825	26.6	3.8	
シリコン製品	Silicon products	642	48.6	501	16.0	22.0	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	785	30.6	723	20.3	7.9	2. 電子デバイス (1) コンピュータシール: 下期は上期比および前年同期比で大幅減少を見込むが、ユーザー製品のFDB化遅れで期初計画を上方修正。 (2) サーモモジュール: 自動車向けは計画通りに推移。半導体関連向け等を下方修正。
装置関連	Equipment related	5,041	21.6	4,897	18.2	2.9	
コンピュータシール	Computer Seals	125	82.4	205	71.2	64.0	(3) 磁性流体・その他: 磁性流体は計画値。SMT(基板実装)を下方修正。
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	1,025	32.8	870	12.7	15.1	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	349	10.1	254	19.9	27.2	
電子デバイス	Electronic devices	1,499	16.8	1,329	26.2	11.3	3. CMS事業: 主力のウエハー加工、装置部品洗浄等は順調に拡大
受託生産	CMS	3,960	77.5	3,792	70.0	4.2	
売上高合計	Total Sales	10,500	28.4	10,018	22.5	4.6	

8. 期初計画と修正計画との差異(通期) Outline of the revised plan (The accounting period)

(単位: 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	05/3通期 期初計画(A)		05/3通期 修正計画(B)			コメント
		Original plan		Revised plan			
		金額 Mil.Yen	前期比 YOY	金額 Mil.Yen	前期比 YOY	計画比 B/A	
売上高	Net Sales	20,000	33.3	20,800	38.7	4.0	1. 連結売上高: 3セグメントいずれも計画を上回る見込み 2. 売上総利益: 売上高の計画超過による。総利益率は31%弱で期初予想とほぼ同値。 3. 販管費: 経費削減の継続と下期の円高を考慮
売上原価	Cost of sales	13,887	35.9	14,412	41.0	3.8	
売上総利益	Gross profit	6,113	27.9	6,388	33.6	4.5	
販管費	SG&A expenses	4,913	17.9	4,738	13.7	3.6	
営業利益(A)	Operating Income	1,200	95.1	1,650	168.3	37.5	
営業外損益	Other income	351	-	350	-	-	
経常利益	Recurring income	850	-	1,300	-	52.9	
特別利益	Extraordinary gain	5	95.1	72	30.1	1340.0	
特別損失	Extraordinary loss	285	41.1	395	18.4	38.6	
税引前利益	Income before taxes	570	-	977	-	71.4	
法人税等	Income tax & others	220	155.8	357	315.1	62.3	
当期利益	Net income	350	-	620	-	77.1	

事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		05/3通期 期初計画(A)		05/3通期 修正計画(B)			コメント
製品	Product type	Original plan		Modification plan			
		金額 Mil.Yen	前期比 YOY	金額 Mil.Yen	前期比 YOY	計画比 B/A	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	3,692	18.9	3,900	25.6	5.6	1. 装置関連: 下期の想定は保守的ながら、上期の好調による 2. 電子デバイス (1) コンピュータシール: ユーザー製品のFDB化遅れによる (2) サーモジュール: 自動車向けは計画通り。自動車向け以外が計画超過。 (3) 磁性流体・その他: SMT(基板実装)の計画修正 3. CMS事業 ウエハー加工が順調に拡大、認定獲得が進んだ装置部品洗浄も業績へ寄与。
石英製品	Quartz	3,490	31.3	3,919	47.4	12.3	
シリコン製品	Silicon products	1,174	43.0	998	21.6	15.0	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	1,445	8.0	1,419	6.1	1.8	
装置関連	Equipment related	9,801	23.7	10,236	29.2	4.4	
コンピュータシール	Computer Seals	686	49.7	902	33.8	31.5	
サーモジュール	Thermo-electric Modules	1,972	25.0	1,998	26.7	1.3	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	689	1.3	544	20.0	21.0	
電子デバイス	Electronic devices	3,347	7.5	3,444	4.8	2.9	
受託生産	CMS	6,852	98.1	7,120	105.9	3.9	
売上高合計	Total Sales	20,000	33.3	20,800	38.7	4.0	

9. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

Activities & Prime Item	03/9	04/9	コメント	
税金等調整前利益 Income before income taxes	543	729	損益の改善で運転資金増加を吸収、営業CFが増加	
減価償却費 Depreciation and Amortization	620	650		
為替損益 Net loss or gain on foreign exchange	26	126		
売上債権の増減額 Changes in Notes and accounts receivable	102	932		
たな卸資産の増減額 Changes in Inventories	2	228		
仕入債務の増減額 Changes in Notes and accounts payable	23	465		
その他 Others	679	512		
. 営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	701	1,070		連調勘定償却 210百万円含む
有形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of tangible fixed assets	910	1,100		中国工場設備投資
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of tangible fixed assets	43	90		
投資有価証券、有価証券の取得による支出 Payments for purchase of marketable securities and investments in securities	327	7		
投資有価証券、有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of marketable securities and investments in securities	80	146		
その他 Others	179	82		
. 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	1,293	953	前年同期はアメリゴン株式の追加取得等	
短期借入金の増減額 Change in Short-term borrowing	144	555	短期借入れの主な実績 フェローテック:500百万円 長期借入れの主な実績 フェローテック:400百万円 杭州:124百万円 長期借入金の主な返済実績 フェローテック:900百万円 上海117百万円	
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term debt	1,679	603		
長期借入金の返済による支出 Payments of long-term debt	1,271	1,274		
配当金の支払額 Payments for dividend	136	135		
その他 Others	59	0		
. 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from Financing activities	69	251		
. 現金及び現金等価物の中間期末残高 Cash & Cash Equivalent	2,336	2,973		

10. 連結セグメント別売上高・営業利益 Segment Information (Consolidated)

事業別 Operations in Business Segments

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

決算期 Accounting Period		04/3上	04/3下	04/3通期	構成比	増減率	05/3上	増減率	05/3下	増減率	05/3通期	構成比	増減率
製品 Product Lines		1st Half	2nd Half	Year Ended	Share	YOY	1st Half	GrowthRate	2nd Half	YOY	Year Ended	Share	YOY
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	1,436	1,669	3,105	20.7	3.2	2,052	42.9	1,848	10.7	3,900	18.8	25.6
石英製品	Quartz	1,216	1,442	2,658	17.7	15.9	2,094	72.2	1,825	26.6	3,919	18.8	47.4
シリコン製品	Silicon related products	389	432	821	5.5	-	497	-	501	-	998	4.8	-
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	737	601	1,338	8.9	0.8	696	5.6	723	20.3	1,419	6.8	6.1
装置関連	Equipment Related	3,778	4,144	7,921	52.8	15.6	5,339	41.3	4,897	18.2	10,236	49.2	29.2
コンピュータシール	Computer Seals	652	711	1,363	9.1	14.0	697	6.9	205	71.2	902	4.3	33.8
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	805	772	1,577	10.5	42.1	1,128	40.1	870	12.7	1,998	9.6	26.7
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	363	317	680	4.5	45.3	290	20.1	254	19.9	544	2.6	20.0
電子デバイス	Electronic devices	1,819	1,801	3,619	24.1	15.2	2,116	16.3	1,328	26.3	3,444	16.6	4.8
受託生産	CMS	1,227	2,231	3,458	23.1	100.8	3,328	171.2	3,792	70.0	7,120	34.2	105.9
売上高合計	Total Sales	6,824	8,176	15,000	100.0	16.8	10,783	58.0	10,017	22.5	20,800	100.0	38.7

装置関連	Equipment related	27	347	374	60.8	-	692	2463.0					
電子デバイス	Electronic devices	206	273	479	77.9	4.4	316	53.4					
受託生産	CMS	202	19	221	35.9	-	75	-					
全社	All	14	3	17	2.8	-	21	-					
営業利益合計	Operating Income	16	598	615	100.0	452.6	1,063	6162.5	587	1.8	1,650		168.3

ご参考 営業利益

11. 主要製品の売上推移 Change in sales of main products

(1) 売上高 Net Sales

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

決算期 Accounting Period	単体 Nonconsolidated			連結 Consolidated					
	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3e	
真空シール・部品 Vacuum Feedthroughs	715	1,334	2,181	5,100	3,931	3,208	3,105	3,900	
石英製品 Quartz	665	1,096	1,572	3,670	3,050	2,293	2,658	3,919	
シリコン製品 Silicon related products	-	-	-	-	-	-	821	998	
EB-ガン・その他 EB-Gun & Others	-	-	-	1,503	2,134	1,349	1,338	1,419	
装置関連 Equipment Related	1,380	2,430	3,753	10,273	9,115	6,851	7,921	10,236	
コンピュータシール Computer Seals	3,086	2,587	2,585	2,585	2,209	1,585	1,363	902	
サーモモジュール Thermo-electric Modules	305	410	591	1,150	893	1,110	1,577	1,998	
ハードディスク関連 HDD products	179	502	828	880	467	332	-	-	
磁性流体・その他 Ferofluid & Others	208	385	966	1,547	1,421	1,243	680	544	
電子デバイス Electronic devices	3,778	3,884	4,970	6,162	4,990	4,270	3,619	3,444	
受託生産 CMS	-	-	-	-	670	1,722	3,458	7,120	
売上高合計 Total Sales	5,158	6,314	8,723	16,435	14,775	12,845	15,000	20,800	

(2) 増減率 Growth Rate

(単位 %)

決算期 Accounting Period	単体 Nonconsolidated			連結 Consolidated					
	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3e	
真空シール・部品 Vacuum Feedthroughs	34.7	86.6	63.5	-	22.9	18.4	3.2	25.6	
石英製品 Quartz	-	64.8	43.4	-	16.9	24.8	15.9	47.4	
シリコン製品 Silicon related products	-	-	-	-	-	-	-	21.6	
EB-ガン・その他 EB-Gun & Others	-	-	-	-	42.0	36.8	0.8	6.1	
装置関連 Equipment Related	26.0	76.1	54.4	-	11.3	24.8	15.6	29.2	
コンピュータシール Computer Seals	39.6	16.2	0.1	-	14.5	28.2	14.0	33.8	
サーモモジュール Thermo-electric Modules	25.6	34.4	44.1	-	22.3	24.3	42.1	26.7	
ハードディスク関連 HDD products	62.8	180.4	65.0	-	46.9	28.9	-	-	
磁性流体・その他 Ferofluid & Others	54.9	85.1	150.8	-	8.1	12.5	45.3	20.0	
電子デバイス Electronic devices	6.0	2.8	28.0	-	19.0	14.4	15.2	4.8	
受託生産 CMS	-	-	-	-	-	157.0	100.8	105.9	
売上高合計 Total Sales	10.7	22.4	38.2	-	10.1	13.1	16.8	38.7	

(3) 構成比 Share

(単位 %)

決算期 Accounting Period	単体 Nonconsolidated			連結 Consolidated					
	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3e	
真空シール・部品 Vacuum Feedthroughs	13.9	21.1	25.0	31.0	26.6	25.0	20.7	18.8	
石英製品 Quartz	12.9	17.4	18.0	22.3	20.6	17.9	17.7	18.8	
シリコン関連 Silicon related products	-	-	-	-	-	-	5.5	4.8	
EB-ガン・その他 EB-Gun&Others	-	-	-	9.1	14.4	10.5	8.9	6.8	
装置関連 Manufacturing Eqpt Related	26.8	38.5	43.0	62.5	61.7	53.3	52.8	49.2	
コンピュータシール Computer Seals	59.8	41.0	29.6	15.7	15.0	12.3	9.1	4.3	
サーモモジュール Thermo-electric Modules	5.9	6.5	6.8	7.0	6.0	8.6	10.5	9.6	
ハードディスク関連 HDD products	3.5	7.9	9.5	5.4	3.2	2.6	-	-	
磁性流体・その他 Ferro Fluid & Others	4.0	6.1	11.1	9.4	9.6	9.7	4.5	2.6	
電子デバイス Electric devices	73.2	61.5	57.0	37.5	33.8	33.2	24.1	16.6	
受託生産 CMS	-	-	-	-	4.5	13.4	23.1	34.2	
売上高合計 Total Sales	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	